

## 操作说明

描述镀膜仪的基本操作说明，按照如下的操作流程操作设备是非常重要的，不按照操作流程操作设备可能会导致仪器的损坏和人员的受伤（如果不确定：请问我们或您的购买渠道相关人员）。

- 确保已经按照上述章节正确的安装好设备。
- 打开 POWER（真空系统开始运转）。
- 设置 TIME-SECONS（不超过 999 秒）。
- 调整 LEAK 旋钮（观察真空计的腔体压强达到预期值）。
- 确保 SYSTEM 灯是亮的（灯泡为亮）。
- 然后：快速按下、放开 SET PLASMA 按键（同时观察 PROCESS CURRENT 电流，确保 PROCESS CURRENT 的显示度数在“**20mA**”以下）。  
如果 PROCESS CURRENT 的显示度数超过 **20mA**，则需要调节 SPUTTERING VOLTAGE 开关（主机后面板）并调节 LEAK 旋钮（主机前面板）。
- 按下 START PROCESS 按钮（系统开始溅射）。
- 溅射结束，关闭 POWER（真空系统停止运转）。
- 拎起上盖并拿出样品，将上盖放回真空腔体上。

## 溅射靶材更换

- 确认仪器处于关机状态。
- 拿起上盖并反方向转动第一个套环。
- 反方向转动第二个套环。
- 放置一个新的靶材在中心位置（如下图）。
- 顺时针拧紧第二个套环（慢一点、拧牢固）。
- 顺时针拧紧第一个套环。
- 将溅射上盖放回真空腔体上。

